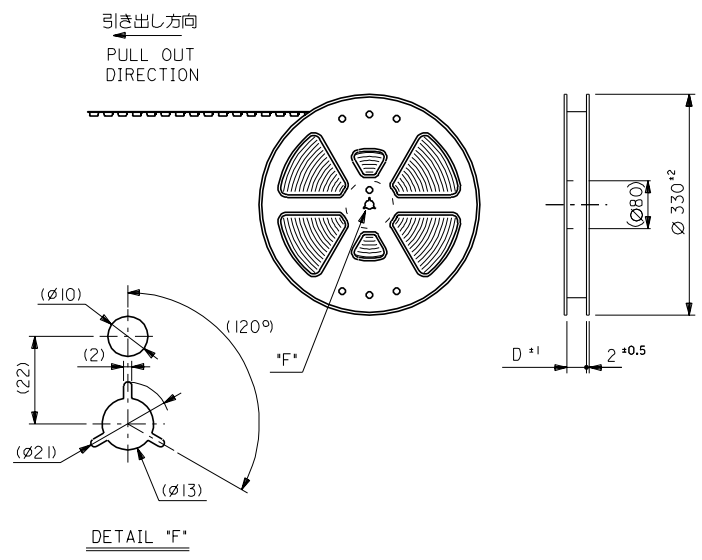


DWG. NO. SD-52745-***90

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



5. 材料
 キャリアテープ:ポリプロピレン (PP)
 トップテープ:PET, PE, PEF
 リール:ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

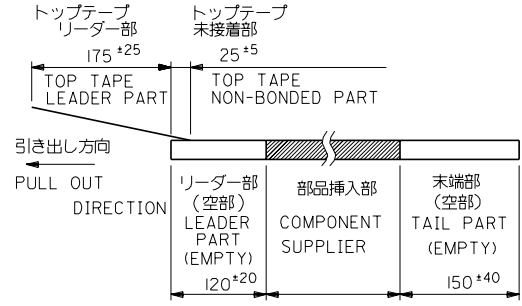
MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
 TOP TAPE:PET,PE,PEF
 REEL:POLYSTYRENE(PS)
 <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

注記 NOTES

1. 製品番号 52745-***17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
 詳細寸法については図面 SD-52745-***17 を参照下さい。
 IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52745-***17 SHOULD BE LOCKED
 RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52745-***17

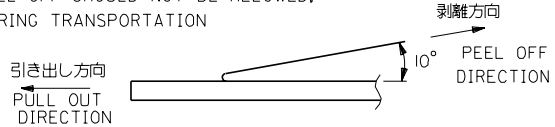
2. 梱包数量:1000個/リール
 NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



4. トップテープの剥離強度:(剥離方向は下図参照)
 0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
 (但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
 0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
 THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
 PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
 DURING TRANSPORTATION

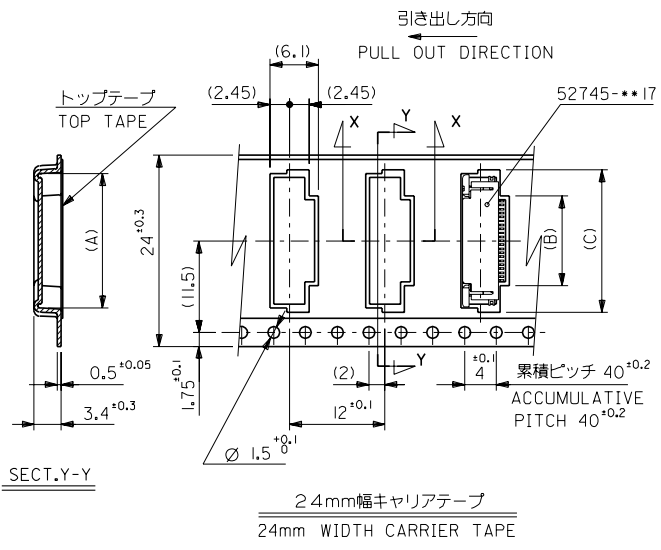


角度 ANGLE		130°				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	+0.2	B	変更 REVISIED (J402001-0425)	4/25	00/12/20	仕上げ FINISH	—	
10以上 未満 OVER 30 UNDER	+0.25	A	変更 REVISIED (J40949)	4/11	94/11/17	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
10未満 UNDER	+0.2	O	新規/再発注 RELEASED (J40230)	5/25	94/3/24	被覆外径 INS. RANGE	—	0.5 FPC Conn ZIF SMT RA Upper Contact Embstp Pkg
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 ITR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	DRAWN BY:94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY:00/12/20 S.KUNISHI	DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52745-***90

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



24	25.5	17.4	10.8	16.4	52745-2090	20
		16.9	10.3	15.9	-1990	19
		16.4	9.8	15.4	-1890	18
		15.9	9.3	14.9	-1790	17
		15.4	8.8	14.4	-1690	16
		14.9	8.3	13.9	-1590	15
		14.4	7.8	13.4	-1490	14
		13.9	7.3	12.9	-1390	13
		13.4	6.8	12.4	-1290	12
		12.9	6.3	11.9	-1190	11
		12.4	5.8	11.4	-1090	10
11.9	5.3	10.9	-0990	9		
11.4	4.8	10.4	-0890	8		
10.9	4.3	9.9	-0790	7		
10.4	3.8	9.4	52745-0690	6		
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		D	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.
						極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	130°				材料 MATERIAL
30以上 OVER	+0.5	B	変更 REVISED	UC2001-0425	SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3
10以上 未過	+0.25	A	変更 REVISED	J409491	仕上げ FINISH
10 UNDER	+0.2	O	新規/再 RELEASED	J40230	適用電線範囲 WIRE RANGE
一般公差 GENERAL TOLERANCES					被覆外径 INS. RANGE
					DRAWN BY '98/3/24 S.AIHARA
					CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
					APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA
					尺度 SCALE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 FPC Conn ZIF SMT RA
Upper Contact
Embstp Pkg

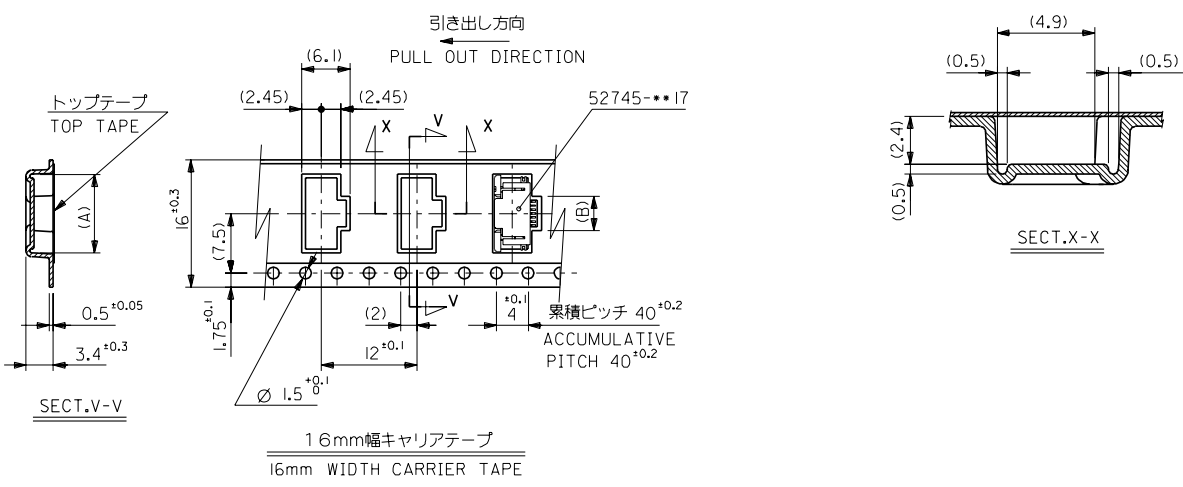
DWG. NO. (SHEET 2 OF 3) REV B
SD-52745-***90

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52745-***90

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

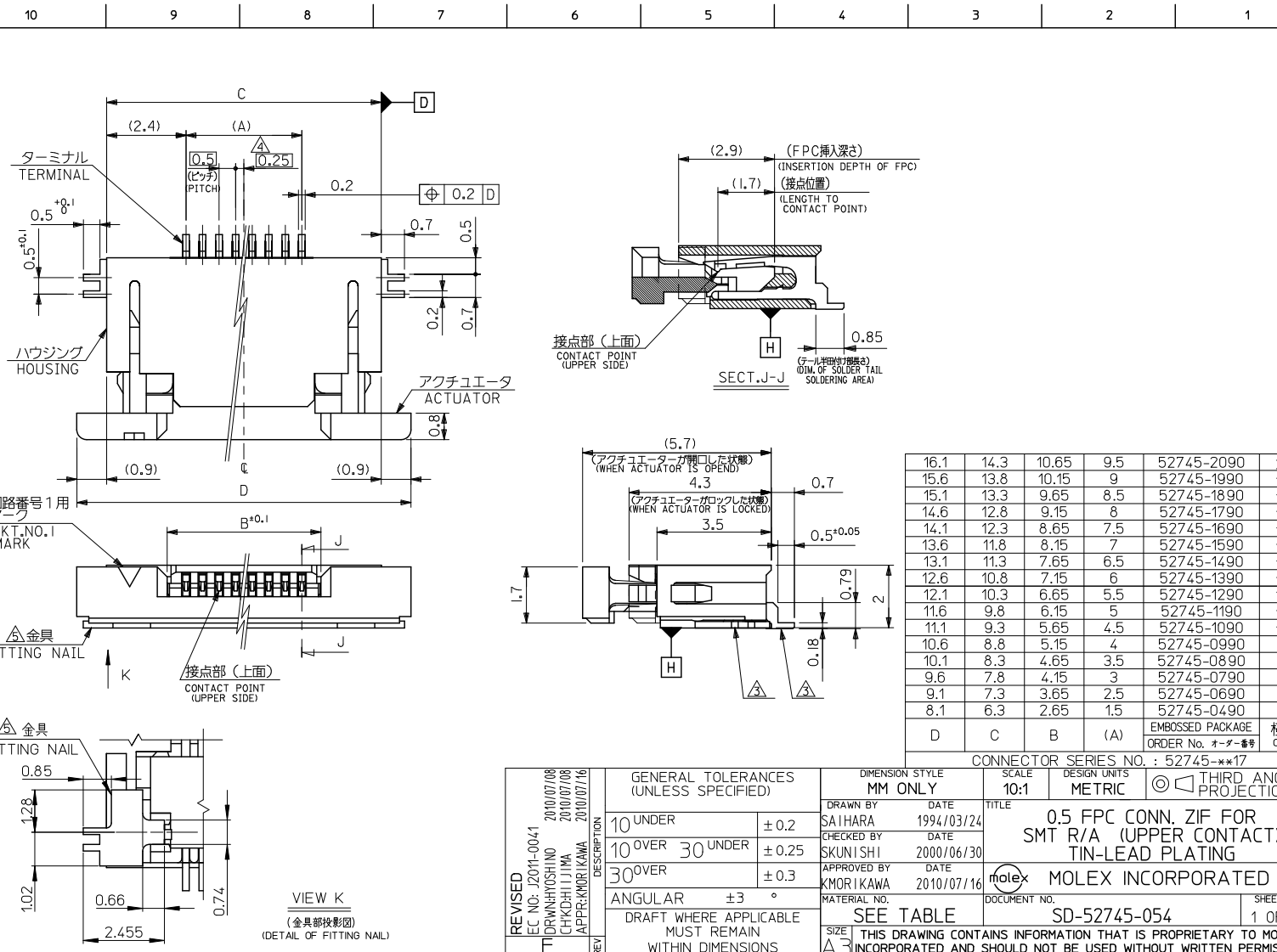


16	17.5	2.8	8.4	52745-0490	4			
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH				D	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL	モジュール MODULE	部品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	材料 MATERIAL	モジュール MODULE	部品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.
SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3							
仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '98/3/24 S. AIHARA	CHK'D BY '00/12/20 S. KUNISHI	TITLE 名称 0.5 FPC Conn ZIF SMT RA Upper Contact Embstp Pkg		
DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV SD-52745-***90	REVISION RECORD			REVISION ONLY ON CAD SYSTEM			

角度 ANGLE	30°				
30以上 OVER	+0.05	B	変更 REVISED (JC2001-0425)	10/12/20	
10以上 未過 30 UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (J40949)	94/11/17	
10 UNDER	+0.2	O	新規/再 RELEASED (J40230)	94/3/24	

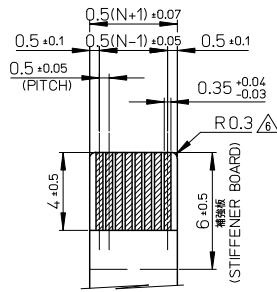
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C1032)MXJ-32



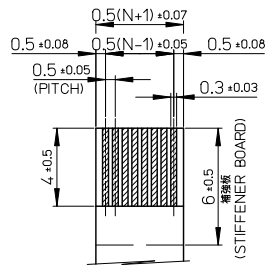
16.1	14.3	10.65	9.5	52745-2090	20
15.6	13.8	10.15	9	52745-1990	19
15.1	13.3	9.65	8.5	52745-1890	18
14.6	12.8	9.15	8	52745-1790	17
14.1	12.3	8.65	7.5	52745-1690	16
13.6	11.8	8.15	7	52745-1590	15
13.1	11.3	7.65	6.5	52745-1490	14
12.6	10.8	7.15	6	52745-1390	13
12.1	10.3	6.65	5.5	52745-1290	12
11.6	9.8	6.15	5	52745-1190	11
11.1	9.3	5.65	4.5	52745-1090	10
10.6	8.8	5.15	4	52745-0990	9
10.1	8.3	4.65	3.5	52745-0890	8
9.6	7.8	4.15	3	52745-0790	7
9.1	7.3	3.65	2.5	52745-0690	6
8.1	6.3	2.65	1.5	52745-0490	4
D	C	B	(A)	EMBOSSED PACKAGE ORDER No. オオーダー番号	極数 CKT.

CONNECTOR SERIES NO. : 52745-***17

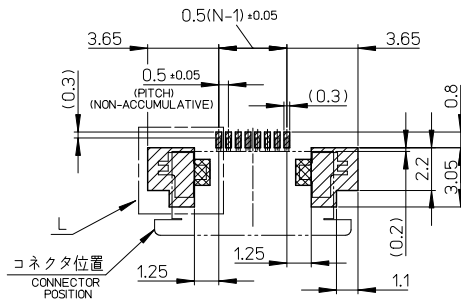
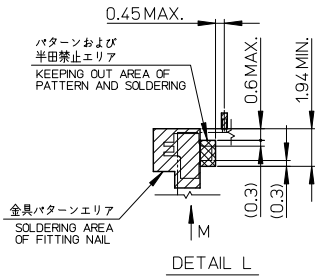
REVISED EC NO: J2011-0041 T: DRW: HYOSHINO 2010/07/08 CHK: KISHIJI MA 2010/07/08 APP: KMORI KAWA 2010/07/16	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY SAIHARA	DATE 1994/03/24	TITLE 0.5 FPC CONN. ZIF FOR SMT R/A (UPPER CONTACT) TIN-LEAD PLATING		
	10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY SKUNISHI	DATE 2000/06/30			
	30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2010/07/16	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-52745-054		
	ANGULAR	± 3 °	MATERIAL NO. SEE TABLE	SIZE A 3			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			



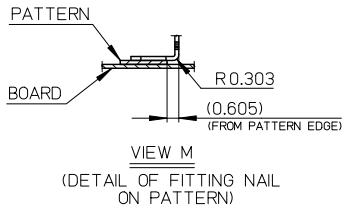
適合金めっきFPC推奨寸法
 APPLICABLE FPC OF GOLD
 PLATING RECOMMENDED DIMENSION
 仕上がり厚さ: 0.3±0.03
 THICKNESS: 0.3±0.03/-0.03



適合金めっきFPC推奨寸法
 APPLICABLE FPC OF GOLD
 PLATING RECOMMENDED DIMENSION
 仕上がり厚さ: 0.3±0.03
 THICKNESS: 0.3±0.03/-0.03



参考基板レイアウト
 (マウント面)
 RECOMMENDED P.C.BOARD
 PATTERN DIMENSION(REF.)
 (MOUNTING SIDE)



注記NOTES

1.使用材料

MATERIAL

ハウジング: 46ナイロン、ガラス充填、UL94V-0、白
 HOUSING: PA46, GLASS FILLED, UL94V-0, WHITE
 アクチュエータ: ポリフェニレンサルファイド (PPS)、ガラス充填、UL94V-0、黒
 ACTUATOR: POLYPHENYLENE SULFIDE, GLASS FILLED, UL94V-0, BLACK
 ターミナル: リン青銅、銅下地半田めっき (±0.2)
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, TIN-LEAD OVER COPPER PLATING
 金具: リン青銅、銅下地半田めっき (±0.2)
 FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE, TIN-LEAD OVER COPPER PLATING

2.エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態になります。

IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.52745-xx*17 SHOULD BE LOCKED.
 ソルダータール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面Hに対して上方向に0.1MAXIMUM、下方向0.15MAXIMUMとする。
 MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM DATUM-H, UPPER DIRECTION: 0.1MAXIMUM, LOWER DIRECTION: 0.15 MAXIMUM

偶数極に適用

APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

ハターン剥離止め金具

FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.W.B. PATTERN.

R0.3は、FPCの胴体部にかからないこと
 R0.3 MUST NOT BE OVERLAPED TO PATTERN OF FPC.

FPCについて:

打抜き方向は導体側から補強板を推奨致します。
 補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
 接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
 RECOMMENDED MATERIAL : STIFFENER FILM : POLYIMIDE
 BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED IEC NO: J2011-0041 T: DRW: HYO SHINO 2010/07/08 CHYK DHI L I J IMA 2010/07/08 APPR: KMORI KAWA 2010/07/16 REV DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER	± ---	DRAWN BY SAIHARA	DATE 1994/03/24	TITLE 0.5 FPC CONN. ZIF FOR SMT R/A (UPPER CONTACT) TIN-LEAD PLATING		
	10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY SKUNISHI	DATE 2000/06/30	MOLEX INCORPORATED		
	30 OVER	± ---	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2010/07/16	DOCUMENT NO. SD-52745-054	SHEET NO. 2 OF 2	
ANGULAR ±3 °		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	